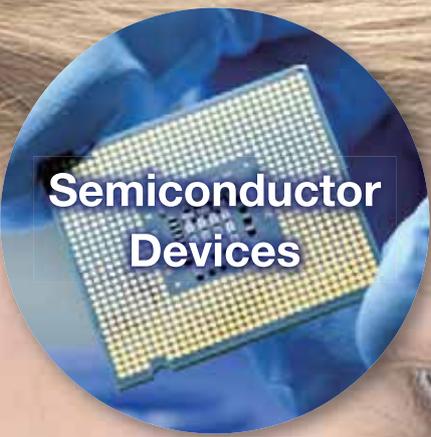




Compound  
Semiconductor



Semiconductor  
Devices



Semi Materials

世界標準の分析技術で課題を解決



Semi Equipment



Consumer  
Electronics



Automotive

## EAGの最新分析技術セミナー【応用編】 『最先端の高感度微小領域分析』

スペシャルゲスト

東海国立大学機構 名古屋大学 未来材料・システム研究所  
新田 州吾 先生 (Shugo NITTA, Ph.D.)

発表  
予定

● GaNパワーデバイス関連の結晶成長技術の現状、及び今後の動向

**Eurofins | EAG Laboratories**

● EAGラボラトリーズのラボ紹介

● 最新のEAG分析技術

● 半導体材料・セラミックスを中心とした絶縁体材料の高精度GDMS分析

● 高分解能STEM-EELSを用いた半導体の界面評価、ひずみ評価

● SIMSを用いた半導体材料における高感度微小領域分析

日時：2023年10月27日(金) 10:30~16:30

参加費：無料

定員：先着100名様

会場：ステーションカンファレンス東京(JR東京駅直結)

お問合せ

ユーロフィンイーエージー株式会社

セミナー運営チーム

JP-Sales@eag.com

03-4330-3709

事前登録はこちらから

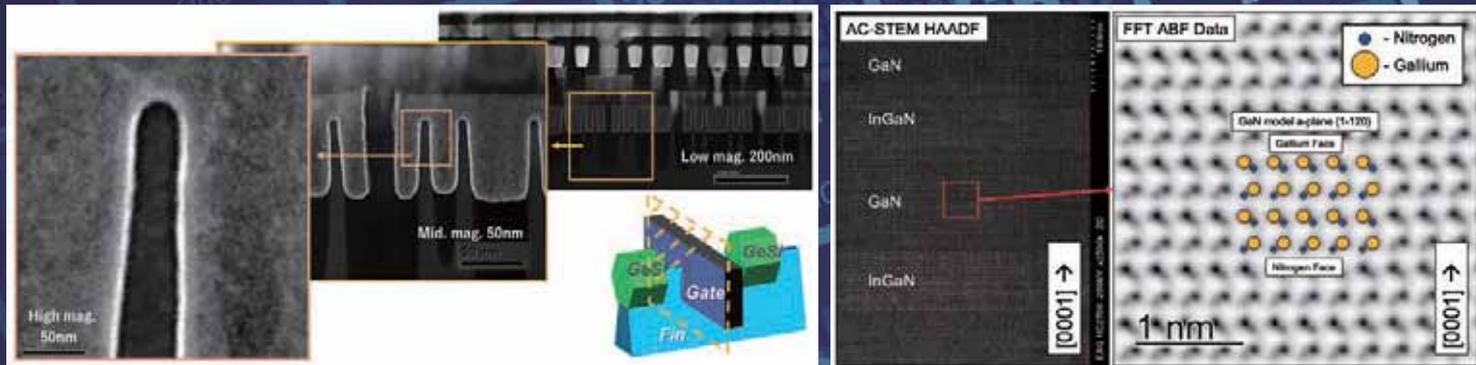


[bit.ly/430tph9](https://bit.ly/430tph9)

# 受託分析 | ユーロフィンEAG

世界標準の技術力でお客様の課題を解決

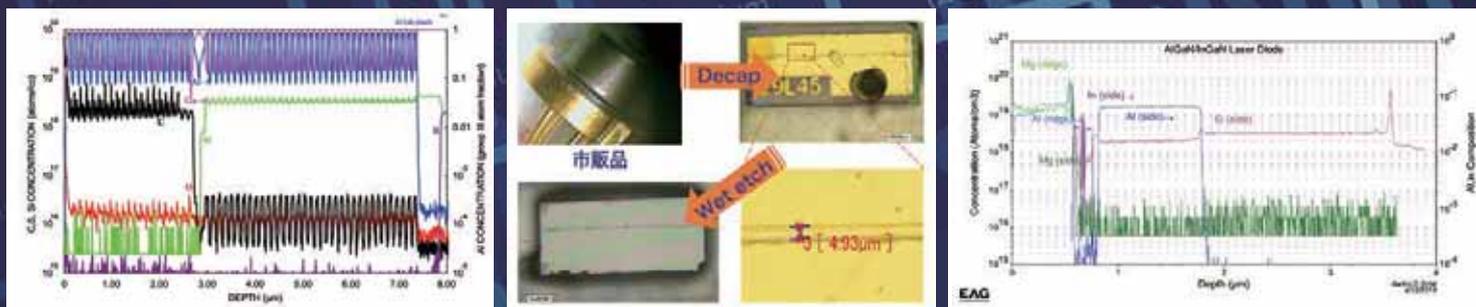
## TEM | 最小0.2nm! 高分解能観察/組成分析



- ナノレベルの原子分解能を誇るAC-STEMを用いた表面/界面分析
- 組成/歪み応力/結晶性など各種物性評価
- 組成分析はEELSに対応し状態分析も可能

TEM/SIMS  
分析納期  
4~8営業日

## SIMS | 業界標準! 高感度/高精度分析



- EAGが誇る世界基準の超高感度SIMS分析
- EAGの独自サービス! 化合物半導体に特化した高精度分析
- 数ミクロン領域の微小分析にも対応

お問い合わせ  
ユーロフィンイーエージー株式会社  
セールスグループ  
JP-Sales@eag.com  
03-4330-3709

お問い合わせ専用  
フォームは  
こちら

